

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2026-054

上海伟测半导体科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年8月14日召开第三届审计委员会第一次会议、第三届独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，现将本公司截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2022年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878号），同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,180.27万股，发行价为每股人民币61.49元，共计募集资金134,064.80万元，坐扣承销和保荐费用7,816.23万元后的募集资金为126,248.57万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,530.62万元后，公司本次募集资金净额为123,717.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-69号）。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行可转换公司债券 1,175 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 117,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 900.00 万元后的募集资金为 116,600.00 万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2025 年 4 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、验资费、律师费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 301.67 万元后，公司本次募集资金净额为 116,298.33 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕6-4 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

1、2022 年首次公开发行股票

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2026 年 3 月 31 日余额	备注
交通银行上海张江支行	310066865013006192536	7,366.92	-	已销户
兴业银行上海杨浦支行	216190100100229975	62,923.98	-	已销户
浦发硅谷银行股份有限公司	10000000000001570	5,000.00	-	已销户
平安银行上海分行营业部	150688868888808	48,828.82	-	已销户
光大银行无锡分行营业部	39920180800378858	-	-	已销户
交通银行南京鼓楼支行	320006600013002774567	-	-	已销户
合 计		124,119.72	-	

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 401.78 万元，系公司 2022 年使用自有资金支付前期发行费 370.83 万元以及 30.95 万元印花税所致。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2026 年 3 月 31 日余额	备注
兴业银行上海大柏树支行	216380100100420264	70,000.00	-	已销户
中信银行上海分行	8110201011501885643	20,000.00	-	已销户
交通银行上海张江支行	310066865013009418191	26,600.00	-	已销户
招商银行无锡分行	511903003310018	-	-	已销户
交通银行南京鼓楼支行	320006600013004712605	-	-	已销户
合 计		116,600.00	-	

[注]初始存放金额与向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额差异为 301.67 万元，系公司前期以自有资金支付尚未完成置换以及尚未支付的保荐费、验资费、律师费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1《2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1《2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让

的情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况说明

1、2022 年首次公开发行股票

本公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 32,201.46 万元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并由其于 2022 年 11 月 11 日出具《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕6-499 号）。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的意见。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,426.03 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 180.07 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计人民币 77,606.10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕6-486 号），公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-030）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2022 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3，2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详

见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2022 年首次公开发行股票

（1）集成电路测试研发中心建设项目无法单独核算效益，公司拟通过该项目进一步购置先进的研发及实验设备，对公司现有核心技术、主要产品以及战略规划中未来拟研发的新技术、新产品及新兴应用领域进行长期深入的研究和开发。通过该项目改善研发环境，提升对人才的吸引力，增强公司核心技术优势和产品竞争力。

（2）补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

（1）伟测半导体无锡集成电路测试基地项目 2025 年 9 月达到预定可使用状态，但截至 2026 年 3 月 31 日不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

（2）偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）2022 年首次公开发行股票

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品情况详见下表：

募集资金现金管理审核情况表

金额单位：人民币万元

发行名称		2022 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2022 年 10 月 21 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
100,000.00	安全性高、流动性好的投资产品	2022 年 11 月 11 日	2023 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 11 日
20,000.00		2023 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 26 日

募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

受托方	产品性质	购买金额	实际获得收益	是否赎回	期末余额
浦发硅谷银行有限公司	结构性存款	1,000.00	3.38	是	0.00

受托方	产品性质	购买金额	实际获得 收益	是否赎回	期末余额
浦发硅谷银行有限公司	结构性存款	2,000.00	8.44	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	30.48	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	34.49	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	10.40	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	20.47	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	16.44	是	0.00
招商银行股份有限公司上海张扬支行	结构性存款	3,000.00	20.94	是	0.00
招商银行股份有限公司上海张扬支行	结构性存款	2,000.00	13.71	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	44.50	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	66.58	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	46.72	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	48.47	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	7.29	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	2,000.00	3.41	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	23.44	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	5.17	是	0.00

受托方	产品性质	购买金额	实际获得 收益	是否赎回	期末余额
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	2,000.00	2.32	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	23.10	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	4.27	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	2,000.00	14.22	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	6.62	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	15.12	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	6.55	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	5,000.00	18.09	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	6,000.00	2.89	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	1,000.00	1.38	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	5,000.00	11.51	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	1,000.00	0.84	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	6,000.00	2.89	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	6,000.00	2.89	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	3,500.00	1.69	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	3,000.00	1.45	是	0.00
中国工商银行股份有限公司南京珠江支行	结构性存款	2,000.00	5.59	是	0.00
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	5,000.00	42.49	是	0.00
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	5,000.00	13.16	是	0.00

受托方	产品性质	购买金额	实际获得 收益	是否赎回	期末余额
中信银行南京中山 东路支行	结构性存款	1,000.00	6.90	是	0.00
交通银行南京鼓楼 支行	结构性存款	5,000.00	14.14	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	4,500.00	10.50	是	0.00
招商银行无锡分行 新区支行	结构性存款	8,000.00	19.96	是	0.00
中信银行无锡新区 支行	结构性存款	2,500.00	10.89	是	0.00
招商银行无锡分行 新区支行	结构性存款	5,000.00	14.75	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	5,000.00	13.75	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	4,000.00	16.50	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	5,000.00	27.50	是	0.00
招商银行无锡分行 新区支行	结构性存款	8,000.00	10.70	是	0.00
招商银行无锡分行 新区支行	结构性存款	5,000.00	11.51	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	5,000.00	12.08	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	4,000.00	9.33	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	5,000.00	11.46	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	5,000.00	17.19	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	3,000.00	6.88	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	3,500.00	7.88	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	2,500.00	5.63	是	0.00
中国工商银行股份 有限公司工博园支 行	结构性存款	2,000.00	5.02	是	0.00
中国工商银行股份	结构性存款	1,500.00	3.30	是	0.00

受托方	产品性质	购买金额	实际获得收益	是否赎回	期末余额
有限公司工博园支行					
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	3,000.00	6.38	是	0.00
招商银行无锡分行新区支行	结构性存款	6,000.00	13.83	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	2,000.00	1.42	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	3,000.00	2.03	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	3,600.00	7.35	是	0.00
中国工商银行股份有限公司工博园支行	结构性存款	3,000.00	7.73	是	0.00
招商银行无锡分行新区支行	结构性存款	2,000.00	4.04	是	0.00
合 计		279,600.00	860.05		0.00

截至 2026 年 3 月 31 日，公司以闲置募集资金进行现金管理取得的收益共计 860.05 万元，余额为 0.00 元。

（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

金额单位：人民币万元

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2025 年 4 月 15 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型产品	2025 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 26 日	2025 年 4 月 27 日

募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

委托方	受托银行	产品类型	购买金额	投资期限	收益
上海伟测半导体科技股份有限公司	交通银行上海张江支行	7 天通知	16,600.00	2025/4/30-2025/5/12	0.53
		结构性存款	10,000.00	2025/5/6-2025/5/27	9.49
		结构性存款	10,000.00	2025/6/3-2025/8/5	24.16
		结构性存款	3,000.00	2025/8/7-2025/8/21	1.38
		结构性存款	7,000.00	2025/8/7-2025/9/4	7.25
		结构性存款	2,000.00	2025/9/8-2025/9/16	0.53
无锡伟测半导体科技有限公司	招商银行无锡分行 新区支行	7 天通知	8,000.00	2025/4/29-2025/5/6	1.56
		7 天通知	4,000.00	2025/5/7-2025/5/19	1.33
		结构性存款	3,000.00	2025/5/12-2025/5/26	2.08
		7 天通知	4,000.00	2025/5/23-2025/6/2	0.83
		7 天通知	5,000.00	2025/5/29-2025/6/9	1.15
		7 天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/17	0.44
		7 天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/25	0.94
		结构性存款	5,000.00	2025/7/8-2025/7/30	4.78
		结构性存款	2,500.00	2025/8/19-2025/9/19	3.74
		结构性存款	1,500.00	2025/9/24-2025/10/10	0.86
合计			87,600.00[注]		61.05

[注]与计划进行现金管理的金额 40,000.00 万元差异系循环购买理财产品所致

截至 2026 年 3 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益为 61.05 万元,余额为 0.00 元。

九、超募资金用于在建项目及新项目的情况

(一) 2022 年首次公开发行股票

1、公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币30,000.00万元分别向全资子公司无锡伟测增资15,000.00万元及向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司(以下简称“南京伟测”)增资15,000.00万元,分别用于投资建设新项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”,独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2022年11月28日,公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

2、公司于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议,审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币10,000.00万元向全资子公司南京伟测提供借款,用于继续实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”,独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023年5月11日,公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。

3、公司于2023年6月30日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币10,000.00万元向全资子公司无锡伟测提供借款,用于继续实施募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”,独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023年7月18日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

(二) 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

不适用。

十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）2022 年首次公开发行股票

1、无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目已于2023年上半年完成全部投资款项支付，截至本项目全部投资款项支付完成之日，节余募集资金（包括利息收入）共计人民币120.47万元，公司已将节余募集资金从募集资金专户转出至一般户并用于补充流动资金，2023年7月公司已将该募集资金专户销户。公司节余募集资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《管理制度》等相关规定。

2、集成电路测试研发中心建设项目已于2023年上半年完成全部投资款项支付，截至本项目全部投资款项支付完成之日，节余募集资金（包括利息收入）共计人民币32.91万元，公司已将节余募集资金从募集资金专户转出至一般户并用于补充流动资金。2023年7月公司已将该募集资金专户销户。公司节余募集资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《管理制度》等相关规定。

受账户利息因素影响，上述节余募集资金数额在募集资金专户销户转出至一般账户时的合计总额为153.76万元。

（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的公告》，同意向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”结项，并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）7.88 万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）及利息收入等永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截至 2026 年 3 月 31 日，募集专户均已注销，节余募集资金 8.17 万元均转至公司基本户和一般户用于永久补充流动资金。

附件：1、2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、2022 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

4、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日

附件 1

2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：123,717.95						已累计使用募集资金总额：124,909.39				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						累计至 2022 年：35,430.68				
						2023 年：88,884.21				
						2024 年：594.50				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	48,828.82	48,828.82	48,797.15	48,828.82	48,828.82	48,797.15	-31.67	2023 年 7 月
2	集成电路测试研发中心建设项目	集成电路测试研发中心建设项目	7,366.92	7,366.92	7,408.42	7,366.92	7,366.92	7,408.42	41.50[注 1]	2023 年 8 月

3	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,019.70	5,000.00	5,000.00	5,019.70	19.70[注 1]	不适用
4	超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	15,000.00	25,000.00[注 2]	25,218.69	15,000.00	25,000.00[注 2]	25,218.69	218.69[注 1]	2025 年 9 月
5	超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	15,000.00	38,347.49[注 3]	38,465.43	15,000.00	38,347.49[注 3]	38,465.43	117.94[注 1]	2024 年 12 月
合 计			91,195.74	124,543.23	124,909.39	91,195.74	124,543.23	124,909.39	366.16	

[注 1]集成电路测试研发中心建设项目、补充流动资金项目、超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目、超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目募集资金实际投资金额大于募集后承诺金额系使用了募集资金的利息收入。

[注 2]本公司于 2023 年 6 月 30 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元向全资子公司无锡伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。上述借款事项经公司股东大会审议通过，公司累计使用部分超募资金 25,000.00 万元实施该项目。

[注 3]本公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元向全资子公司南京伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。本公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用剩余超募资金 13,347.49 万元及孳息向全资子公司南京伟测提供借款以继续实施募投项目，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。上述借款事项经公司股东大会审议通过，公司累计使用部分超募资金 38,347.49 万元实施该项目。

附件 2

2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：116,298.33						已累计使用募集资金总额：116,361.71				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2025 年：116,361.71				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	70,000.00	70,000.00	70,018.42	70,000.00	70,000.00	70,018.42	18.42[注 1]	2025 年 9 月
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	20,000.00	20,000.00	20,000.10	20,000.00	20,000.00	20,000.10	0.10[注 1]	2024 年 12 月
3	偿还银行贷款及补充流	偿还银行贷款及补充流	27,500.00	27,500.00	26,343.18	27,500.00	27,500.00	26,343.18	-1,156.82[注 2]	不适用

	动资金项目	动资金项目								
--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

[注 1]项目累计投入进度大于 100%系使用了部分募集资金的利息收入及投资收益所致。

[注 2]本次发行可转换债券的募集资金总额为人民币 117,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,201.67 万元，实际募集资金净额为 116,298.33 万元。
因本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入总额，“偿还银行贷款及补充流动资金项目”不足部分由公司自筹解决。

2022 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	项目达产后，可实现年平均销售收入 20,135.32 万元	14,030.35[注 1]	16,427.31[注 2]	20,227.74	55,783.11	是
2	集成电路测试研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	项目达产后，可实现年平均销售收入 33,242.40 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]
5	超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	项目达产后，可实现年平均销售收入 31,282.85 万元	不适用	不适用	25,528.27[注 4]	32,463.57	是

[注 1]无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目于 2023 年 7 月达到预定可使用状态，该项目 2023 年实现销售收入 14,030.35 万元。

[注 2]无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目 2024 年实现的销售收入为 16,427.31 万元。项目未达到预计收益的原因主要系 2023 年全球终端市场需求疲软，集成电路行业处于下行周期，2024 年尚处于复苏阶段，产能利用率水平未达到预期所致。

[注 3]伟测半导体无锡集成电路测试基地项目于 2025 年 9 月达到预定可使用状态，但截至 2026 年 3 月 31 日不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

[注 4]伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，该项目 2025 年实现销售收入 25,528.27 万元，原预计该项目建设完毕后产能分三年爬坡实现满产，各年度收入分别为 20,855.23 万元、28,965.60 万元和 31,282.85 万元。2025 年为该项目建设完毕后第一年，2025 年收入已达到预期效益。

2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	项目达产后,可实现年平均销售收入 33,242.40 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 1]
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	项目达产后,可实现年平均销售收入 31,282.85 万元	不适用	不适用	25,528.27[注 2]	32,463.57	是
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]伟测半导体无锡集成电路测试基地项目 2025 年 9 月达到预定可使用状态，但截至 2026 年 3 月 31 日不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

[注 2]伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，该项目 2025 年实现销售收入 25,528.27 万元，原预计该项目建设完毕后产能分三年爬坡实现满产，各年度收入分别为 20,855.23 万元、28,965.60 万元和 31,282.85 万元。本期为该项目建设完毕后第一年，2025 年收入已达到预计效益。